

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 2012 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

### 1.2 公司简介

股票简称	士兰微	股票代码	600460
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈越	马良	
电话	0571-88210880	0571-88212980	
传真	0571-88210763	0571-88210763	
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn	

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

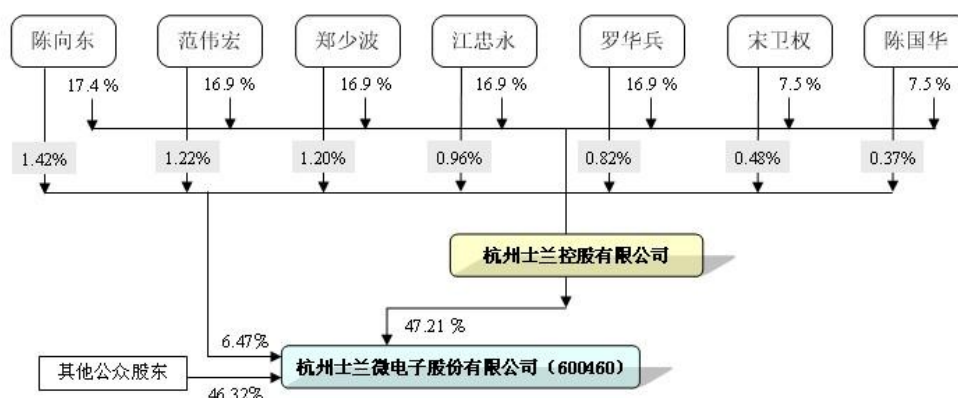
	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2010 年(末)
总资产	3,350,408,146.52	3,317,450,616.71	0.99	2,564,948,734.53
归属于上市公司股东的净资产	1,696,892,031.27	1,709,626,387.46	-0.74	1,658,726,568.91
经营活动产生的现金流量净额	168,159,848.74	220,434,981.70	-23.71	303,881,858.40
营业收入	1,349,024,202.50	1,545,988,665.82	-12.74	1,518,826,971.05
归属于上市公司股东的净利润	18,273,006.58	153,221,469.72	-88.07	255,858,649.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,469,931.67	126,454,728.77	-137.54	222,732,219.22
加权平均净资产收益率 (%)	1.08	9.08	减少 8.00 个百分点	23.54
基本每股收益 (元 / 股)	0.02	0.18	-88.89	0.31
稀释每股收益 (元 / 股)	0.02	0.18	-88.89	0.31

#### 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	48,596	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	60,611		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	47.21	409,878,146		质押 45,600,000
陈向东	境内自然人	1.42	12,311,612		无
范伟宏	境内自然人	1.22	10,556,820		无
郑少波	境内自然人	1.20	10,418,600		无
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.15	10,000,000		无
江忠永	境内自然人	0.96	8,300,000		无
罗华兵	境内自然人	0.82	7,111,420		无
申倩	未知	0.69	6,000,000		无
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	未知	0.69	6,000,000		无
宋卫权	境内自然人	0.48	4,210,000		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权等六人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 管理层讨论与分析

#### (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,公司营业总收入为 134,902 万元,较 2011 年下降 12.74%;公司营业利润为-5,922 万元,比 2011 年减少 142.72%;公司利润总额为 1,454 万元,比 2011 年减少 91.33%;公司归属于母公司股东的净利润为 1,827 万元,比 2011 年减少 88.07%。

2012 年是公司近三年来经营压力最大的一年。2012 年前三个季度,公司营业收入都低于去年同期,且从 2011 年三季度开始,公司营业收入出现了连续三个季度的下滑。公司营业收入下降的主要原因是:受行业竞争加剧的影响,公司发光二极管产品的价格较去年同期有较大幅度的降低,导致发光二极管的营业收入大幅度减少。受外部经济下滑的影响,公司集成电路、分立器件芯片的销售收入也较去年有一定幅度的减少。2012 年四季度,公司生产经营逐步企稳,四季度营业收入较 2011 年同期增长了 5.3%。

2012 年公司营业总成本高于营业总收入,使得营业利润出现较大的负数。营业总成本高于营业总收入的原因:市场萎缩、竞争加剧导致产品毛利下滑,尤其是发光二级管的毛利率降低了约 30 个百分点;公司持续为产品及技术研发、生产线建设、品牌建设投入资金,导致总成本增加,利润减少。

2012 年,尽管公司在经营上面临较大的压力,但公司继续在“技术研发投入、生产能力建设、品牌建设”三个方面取得进展,以下分别就士兰微电子、士兰集成、士兰明芯的运行情况进行描述:

- 士兰微电子: 2012 年士兰微电子实现营业收入 90,317 万元,与 2011 年基本持平,实现净利润 6,134 万元,比 2011 年减少 53.19%。虽然外部市场的低迷状态使士兰微电子的净利润有较大幅度下降,但士兰微电子通过持续的研发投入,加快了系统创新和技术整合,陆续推出了多个新产品,涉及电源电路、LED 驱动电路、电视机高频调谐器电路、高集成度的遥控玩具电路、MCU 电路、高压 HVIC 和智能功率模块等多个产品门类,新产品的量产带动了士兰微电子四季度营业收入出现回升。2012 年,士兰微电子功率器件成品的销售额继续较快成长,带动士兰集成封装线产能利用率在四季度得到快速提升。2012 年,公司在 IGBT、MEMS 传感器、新一代的 LED 大型显示屏控制和驱动系统及电路、应用于高清光盘和数字家庭的芯片与系统等方面的研发上均有较好的进展。2012 年,士兰微电子被中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会等机构共同评为“中国十强半导体企业”。
- 士兰集成: 2012 年士兰集成实现营业收入 7.30 亿元,比 2011 年减少 7.95%,实现净利润 1,757 万元,比 2011 年减少 75.45%。导致士兰集成净利润大幅减少的主要原因是:受外部经济下滑的影响,2012 年一季度士兰集成芯片生产线产能利用率较低,导致其在一季度出现较大的经营性亏损;二、三季度,士兰集成产能利用率逐步回升,盈利情况有所改善。四季度,随着半导体市场回升,以及生产线运行质量的进一步改善,士兰集成盈利能力得到提升。2012 年,士兰集成芯片生产线和封装线的产能都得到进一步提升,芯片生产线产能已经提升至 16-17 万片/月,封装线产能提升至 2350 万只/月。2012 年,士兰集成在高性能 TVS、IGBT、MEMS 等新技术平台上得到突破。2012 年,士兰集成荣获全国五一劳动奖状。
- 士兰明芯: 2012 年士兰明芯实现营业收入 1.55 亿元,比 2011 年减少 54.69%,实现净利润-2,913 万元,比 2011 年减少 152.93%。导致士兰明芯净利润减少的主要原因是:受 LED 行业竞争加剧的影响,2012 年士兰明芯 LED 彩屏芯

片的价格有较大幅度的下降，大幅挤压了产品的利润空间。尽管遇到较大的经营压力，但士兰明芯通过持续的投入，在外延产能的建设、PSS 衬底的工艺完善、芯片质量的改善提升等方面取得了较大的进步。2012 年 12 月，士兰明芯的 LED 外延片产能已经提升至 6 万片/月，LED 管芯的生产能力已提升至 14 亿颗/月。随着产能的扩大，以及外延片和 PSS 衬底实现完全自给，士兰明芯的生产成本已得到较大幅度的降低。2012 年，士兰明芯已开发出照明用 LED 芯片，并实现批量销售。2012 年，士兰明芯子公司——杭州美卡乐光电有限公司的销售业绩未能取得增长，但美卡乐产品质量保持稳定，产品性能得到持续提升（已达到国际大厂的水平），美卡乐品牌已逐步被国内外许多品牌客户所认可，未来订单上升可预期。

2012 年，公司进一步强化了资金管理，通过合理运用各种银行产品，在多元化拓展融资渠道的同时，有效降低了公司的资金成本。

2012 年，公司及子公司共获得专利授权 75 项，集成电路布图设计授权 56 项。截至 2012 年年底，公司及子公司已累计获得各种权利证书 241 项。

2012 年，士兰微电子牵头申报的“面向移动终端和物联网的智能传感器产品制造与封装一体化集成技术”项目，已获科技部“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室立项批准。

## (二)主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,349,024,202.50	1,545,988,665.82	-12.74
营业成本	1,047,681,163.75	1,067,751,070.32	-1.88
销售费用	37,881,346.83	37,030,564.02	2.30
管理费用	254,688,435.66	249,493,135.97	2.08
财务费用	47,305,935.34	45,104,605.99	4.88
经营活动产生的现金流量净额	168,159,848.74	220,434,981.70	-23.71
投资活动产生的现金流量净额	-254,028,128.81	-806,711,794.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-30,610,286.38	439,914,773.01	-106.96
研发支出	144,597,200.34	152,883,528.92	-5.42

### 2、收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年公司营业收入较 2011 年下降了 12.74%，公司营业收入下降的主要原因是：受行业竞争加剧的影响，公司发光二极管产品的价格较去年同期有较大幅度的降低，导致发光二极管的营业收入大幅度减少。受外部经济下滑的影响，公司集成电路、分立器件芯片的销售收入也较去年有一定幅度的减少。2012 年公司功率器件成品的营业收入保持了快速增长，这在一定程度上弥补了公司其他产品收入的下降。

#### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年，公司子公司士兰集成生产芯片 124.97 万片，比 2011 年减少 13.65%；公司子公司士兰明芯生产发光二极管芯片 9,439KK（百万颗），比 2011 年增加 11.77%。

#### (3) 主要销售客户的情况

公司向前 5 名客户销售合计为 34,505.44 万元，占公司营业收入的 25.57%。

公司的前五名客户分别是：杭州友旺电子有限公司，EXAR CORPORATION，东莞市中之进出口有限公司，Chengdu Shunyun Logistics CO.,LTD.，成都先进功率半导体股份有限公司。

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电子元器件		1,047,480,905.16	100	1,066,688,819.38	100	-1.80
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
集成电路		410,519,822.72	39.19	410,566,686.07	38.49	-0.01
器件芯片		336,039,778.86	32.08	345,002,401.61	32.34	-2.60
器件成品		134,797,644.05	12.87	79,696,359.88	7.47	69.14
发光二极管		164,790,162.09	15.73	227,948,458.94	21.37	-27.71
其他		1,333,497.44	0.13	3,474,912.88	0.33	-61.63

说明：

#### 1) 集成电路和分立器件芯片制造成本构成

项目	2012 年	2011 年
主材	24.30%	30.58%
辅材	23.04%	23.53%
人工	18.48%	16.20%
制造费用	34.18%	29.69%
合计	100.00%	100.00%

#### 2) 发光二极管管芯片制造成本构成

项目	2012 年	2011 年
主材	20.62%	51.96%
辅材	24.30%	19.00%
人工	8.06%	4.59%
制造费用	47.02%	24.46%
合计	100.00%	100.00%

**4、费用**

利润表项目	2012 年	2011 年	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	8,629,582.53	5,720,320.70	50.86	主要系本期长期资产总体投资减少,导致可抵扣进项税减少,相应应交流转税及其附加税上升所致。
投资收益	9,546,718.25	18,065,932.15	-47.16	主要系联营企业友旺电子公司本期净利润下降所致。
营业外收入	76,894,680.59	33,098,178.23	132.32	主要系本期收到的政府研发项目补助增加所致。
所得税费用	-5,426,410.67	12,093,111.56	不适用	主要系本期营业利润下降,相应应纳税所得额减少所致。
其他综合收益	-2,232,558.09	-75,076,748.98	不适用	主要系本期按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额变动较少所致。

**5、研发支出****(1) 研发支出情况表**

单位: 元

本期费用化研发支出	144,597,200.34
本期资本化研发支出	
研发支出合计	144,597,200.34
研发支出总额占净资产比例 (%)	8.44
研发支出总额占营业收入比例 (%)	10.72

**6、现金流**

单位: 元

现金流量表项目	2012 年	2011 年	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	168,159,848.74	220,434,981.70	-23.71%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-254,028,128.81	-806,711,794.46	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少,以及理财产品到期赎回回笼资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,610,286.38	439,914,773.01	-106.96	主要系上期发行 6 亿元公司债券募集资金所致。

**(三) 行业、产品或地区经营情况分析****1、主营业务分行业、分产品情况表**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子元器件	1,343,489,555.83	1,047,480,905.16	22.03	-13.00	-1.80	减少 8.89 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
集成电路	572,801,162.60	410,519,822.72	28.33	-4.59	-0.01	减少 3.28 个百分点
器件芯片	430,490,078.14	336,039,778.86	21.94	-11.15	-2.60	减少 6.85 个百分点
器件成品	161,629,847.44	134,797,644.05	16.60	63.99	69.14	减少 2.54 个百分点
发光二极管	174,744,391.49	164,790,162.09	5.70	-50.67	-27.71	减少 29.95 个百分点
其他	3,824,076.16	1,333,497.44	65.13	-41.40	-61.63	增加 18.38 个百分点

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、较为成熟的 IDM 模式

公司从集成电路芯片设计业务开始，逐步搭建了芯片制造平台，并已将产业链延伸至功率器件和功率模块的封装领域，建立了较为成熟的 IDM (Integrated Design & Manufacture, 设计与制造一体) 经营模式。IDM 模式可有效进行产业链内部整合，公司设计研发和工艺制造平台同时发展，形成了特殊工艺技术与产品研究的紧密互动，以及器件、集成电路和模块产品的协同发展。公司依托 IDM 模式形成的设计与工艺相结合的综合实力，提升产品品质、加强控制成本，向客户提供差异化的产品与服务，提高了其向大型厂商配套体系渗透的能力。

##### 2、产品群协同效应

公司从 IC 设计企业完成了向综合性的半导体产品供应商的转变，在半导体大框架下，形成了功率器件、功率模块、集成电路、LED 业务的协同发展，各业务之间相互补充、促进、借鉴。公司在产品销售时，可根据客户需求，给出满足客户需求的产品、组合和方案。进入 LED 业务之后，公司在集成电路业务中积累的技术、人才资源和管理经验，成为 LED 业务发展的后盾，公司还结合对两个领域较为深入的理解，推出了 LED 驱动电路系列产品，与 LED 芯片业务形成互动。

##### 3、较为完善的技术研发体系

公司已经建立了可持续发展的产品和技术研发体系。公司的研发工作主要可分为两个部分：芯片设计研发与工艺技术研发。在芯片设计研发方面，公司以 IPD (集成产品开发管理体系) 为引导，依照产品的技术特征，将技术研发工作根据各产品线进行划分。公司持续推

动新产品开发和产业化,根据市场变化不断进行产品升级和业务转型,保持了持续发展能力。在工艺技术平台研发方面,公司已开发并运用国内较为领先的 BCD 工艺制造平台,形成了自身的特殊工艺。这一方面保证了公司产品品质及种类的多样性,提升了生产效率、有效降低成本;另一方面也支撑了公司电源管理、功率驱动、功率模块、功率器件、MEMS 器件等各系列产品的研发。公司依托在半导体行业积累的技术和经验,将业务拓展至 LED 领域,攻克了芯片的 ESD 防护问题、图形化衬底、金属淀积质量、MOCVD 外延参数均匀性等一系列技术关口,在提升产品品质的同时,有效的降低了生产成本。

#### 4、面向全球品牌客户的质量控制

公司依托产品研发和工艺技术的综合实力提升和保证产品品质。公司还通过研发各项测试工艺,加强对各种封装形式的集成电路、功率器件、功率器件成品的测试能力。目前公司已经获得了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证、索尼 GP 认证、欧盟 ROHS 认证、ECO 认证等诸多国际认证,产品已经得到了欧司朗、三星、LG、索尼、达科、巴可等全球品牌客户的认可。公司设计研发、芯片制造、测试系统的综合实力,保证了产品品质的优良和稳定,是公司参与市场竞争、开发高端市场、开发高品质大客户的保障。

#### 5、优秀的人才队伍

公司已拥有了一支规模在 300 人以上的产品设计和各类技术研发队伍,公司及主要子公司中,具有博士、硕士学历的技术人员超过 80 人。公司还建立了较为有效的技术研发管理和激励制度,保证其人才队伍的稳定,为公司在竞争激烈的半导体行业中保持持续的技术研发能力和技术优势奠定了基础。

### (五) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### 1、行业竞争格局和发展趋势

##### (1) 国内半导体行业竞争格局

目前世界半导体行业向我国转移的趋势没有改变,我国已成为全球主要的半导体生产国家之一。境外大型半导体公司在国内投资快速增长,但技术、研发的导入却未能同步发展。出于对核心技术的保护,发达国家对关键技术和先进设备的输出对我国进行限制。外资厂商凭借其雄厚的资金实力和技术积累占据了较大的市场份额,并在某些高端半导体设计和制造方面甚至处于垄断地位。而我国半导体企业的技术积累和规模效应较国际大厂仍有较大差距,以代工为主要业务存在的中小厂企业较多,具有自主核心技术和先进生产工艺的企业较少,市场竞争手段以价格竞争为主。从半导体行业最为注重的规模效应来看,我国优势半导体企业仍亟待加强。

##### (2) 我国集成电路行业发展趋势

根据国家工业和信息化部发布的《集成电路产业“十二五”发展规划》:“十二五”末,我国集成电路产业规模再翻一番以上,关键核心技术和产品取得突破性进展,形成一批具有国际竞争力的企业。“十一五”期间,我国集成电路产业规模持续扩大,产量和销售收入分别从 2005 年的 265.8 亿块和 702 亿元,提高到 2010 年的 652.5 亿块和 1,440 亿元,占全球集成电路市场比重从 2005 年的 4.5% 提高到 2010 年的 8.6%。同时,创新能力显著提升,产业结构进一步优化,企业实力明显增强。工信部预计,到 2015 年,国内集成电路市场规模将超过 1 万亿元人民币。为实现集成电路产业健康持续发展,工信部提出,到“十二五”末,集成电路产量超过 1,500 亿块,销售收入达 3,300 亿元,年均增长 18%,占世界集成电路市场份额的 15% 左右,满足国内近 30% 的市场需求。行业结构将进一步调整,将着重加强产业链上游建设,芯片设计业占全行业销售收入比重将提高到三分之一左右,芯片制造业、封装测试业比重将占三分之二。芯片的先进设计能力将达到 22 纳米,将开发一批具有自主知识产权的核心芯片,国内重点整机应用自主开发集成电路产品的比例将达到 30% 以上。同时,将

继续强化以长三角、京津环渤海和泛珠三角的三大集聚区，以重庆、成都、西安、武汉为侧翼的产业布局，建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的产业集聚区。

### (3) 2012 年全球半导体市场概述

2012 年，由于受到欧债危机等因素的影响，全球半导体行业整体较为低迷。根据美国半导体产业协会(SIA)引用世界半导体贸易统计组织(WSTS)资料所公布的最新统计数据，2012 年全球半导体销售额总计达到 2,916 亿美元，较 2011 年的 2,995 亿美元减少 2.7%，为近三年首次负增长。伴随着美国经济的逐步复苏，全球半导体市场在 2012 年四季度有所反弹。2012 年四季度全球半导体销售额为 742 亿美元，较 2011 年同期增长 3.8%。其中，美洲地区显示持续增长的迹象，美洲地区四季度销售额同比增长 12%，其 12 月份的销售额同比增长 13.4%。亚太地区在四季度开始呈现触底迹象，亚太地区 2012 年 12 月的半导体销售额同比增长 6.7%，已连续 2 个月高于上年同期。在美洲地区强劲增长的推动下，预计 2013 年全球半导体市场将进一步改善，WSTS 预测 2013 年全球半导体市场销售额可增长 4.5%。

## 2、公司面临发展的战略机遇期

近几年，全球金融危机、欧债危机的频频发生，使得全球经济增速放缓，这给国内经济的发展带来较大的外部压力。但从国际环境看，我国发展仍处于重要的战略机遇期。我们面临的机遇，不再是简单纳入全球分工体系、扩大出口、加快投资的传统机遇，而是倒逼我们扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变的新机遇。党的“十八大”提出“实施创新驱动发展战略”，将科技创新摆在国家发展全局的核心位置。士兰微电子经过十多年的发展，坚持走“设计制造一体化”道路，在多个产品技术领域构建了核心竞争优势。近几年，士兰微电子通过承担国家重大科技专项，在新技术新产品新工艺研发应用上取得重大突破，这为公司今后可持续发展增添了动力。随着人们对“绿色、节能、环保”的关注度的日益提高，推动了人类向节能型、环保型社会的转型，促进了以 LED、智能功率器件和模块为代表的诸多半导体信息技术的快速发展，并在人民生活传统产业节能、环保、信息化升级改造的过程中发挥了不可替代的重要作用。半导体信息技术在节能、环保领域的广泛的应用催生了半导体行业更为广阔的市场空间。士兰微电子将继续坚持 IDM 模式，紧紧抓住市场对节能、环保产品需求日益增长的战略机遇期，加快对智能功率模块、IGBT、LED 照明芯片、电源驱动 IC、MEMS 器件等新产品的开发，大力推进系统创新和技术整合，不断提升产品的附加值，在创造良好经济效益的同时，积极创造社会效益。

## 3、公司发展战略

公司发展战略是：成为国内最大的自有品牌的半导体产品制造商。

- 在高压 BCD 工艺、高压分立器件的研发上加大投入，争取在 AC-DC 电源、LED 照明驱动、功率模块等产品领域取得较大的进展，树立品牌，大幅度拓展市场。
- 继续在数字音视频（含安防监控、光盘伺服系统）领域投入，巩固并拓展应用市场。
- 继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展，在特殊工艺领域坚持走 IDM（设计与制造一体）的模式。继续推进成都半导体生产基地的建设，做好生产启动的各项准备工作。
- 加快推进功率模块的封装业务，充分发挥公司在高压电路与器件芯片研发、芯片制造、应用系统开发的综合优势，追随高压、高功率产品应用市场的快速发展。
- 继续加大分立器件芯片的技术和产品研发投入，加快 IGBT、MEMS 等先进器件的开发，增加器件芯片的技术附加值。
- 持续在 LED 芯片领域投入，在 LED 彩屏芯片已取得较好优势的产业基础上，加快发展照明 LED 芯片业务。
- 打造士兰“美卡乐”高端 LED 成品品牌，积极拓展海内外高端客户，提升产品价值。

#### 4、经营计划

##### (1) 公司的产品线规划

2013 年公司产品线规划基本没有改变，将按六个方面进行规划、管理和运行：电源和功率驱动产品线、数字音视频产品线、MCU 产品线、混合信号与射频产品线、分立器件产品线、LED 器件产品线等。

##### (2) 对 2013 年营业总收入的预计

预计 2013 年公司将实现营业总收入 17 亿元左右（预计比 2012 年增长 26%左右），营业总成本将控制在 16 亿元左右。

董事长：陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司

2013 年 3 月 3 日